



## 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年10月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東  
コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 仙洞田 哲也  
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 横川 久 TEL 045-478-7111  
配当支払開始予定日 —  
決算補足説明資料作成の有無： 有  
決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2025年6月期第1四半期の連結業績（2024年7月1日～2024年9月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年6月期第1四半期	36,737	△22.3	15,922	54.9	12,728	16.5	8,930	16.0
2024年6月期第1四半期	47,305	83.9	10,279	20.8	10,929	18.3	7,702	14.4

(注) 包括利益 2025年6月期第1四半期 6,795百万円 (△12.2%) 2024年6月期第1四半期 7,744百万円 (13.4%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年6月期第1四半期	99.03	98.94
2024年6月期第1四半期	85.40	85.33

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年6月期第1四半期	261,263	143,952	55.1	1,595.90
2024年6月期	271,288	151,315	55.8	1,677.55

(参考) 自己資本 2025年6月期第1四半期 143,930百万円 2024年6月期 151,294百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年6月期	—	73.00	—	157.00	230.00
2025年6月期	—	—	—	—	—
2025年6月期（予想）	—	115.00	—	173.00	288.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

### 3. 2025年6月期の連結業績予想（2024年7月1日～2025年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	240,000	12.4	104,000	27.8	104,000	26.8	74,000	25.3	820.52

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更： 無  
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2025年6月期1Q	94,286,400株	2024年6月期	94,286,400株
② 期末自己株式数	2025年6月期1Q	4,098,919株	2024年6月期	4,098,919株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2025年6月期1Q	90,187,481株	2024年6月期1Q	90,183,802株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

(決算説明会内容の入手方法について)

当社は、2024年10月31日(木)に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(収益認識関係)	9
3. 補足情報	10
(1) 品目別生産実績	10
(2) 品目別販売実績	10

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、地政学リスクや金融引き締めによる景気減速が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続きました。

このような状況下、当社グループの主要販売先である半導体業界においても、先端半導体の製造能力の増強に関わる投資計画の一部で見直しが行われています。特定の分野においては、生成AI向けHBM（広帯域メモリ）関連への投資は堅調に推移した一方で、EV（電気自動車）市場の減速などを背景にパワー半導体関連への投資には一服感が見られました。

当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては367億37百万円（前年同期比22.3%減少）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が256億81百万円（前年同期比38.5%減少）、その他が10億95百万円（前年同期比606.6%増加）、サービスが99億60百万円（前年同期比85.6%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が159億22百万円（前年同期比54.9%増加）、経常利益が127億28百万円（前年同期比16.5%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が89億30百万円（前年同期比16.0%増加）となりました。

### (2) 当四半期の財政状態の概況

#### ①財政状態

当第1四半期連結会計期間末における総資産は2,612億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ100億24百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が91億69百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が88億58百万円、現金及び預金が74億96百万円、流動資産のその他が26億55百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、当第1四半期連結会計期間末残高は1,173億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億60百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が100億円、賞与引当金が16億68百万円増加したものの、未払法人税等が106億53百万円、繰延収益が20億64百万円、流動負債のその他が17億37百万円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は1,439億52百万円となり、また自己資本比率は55.1%となりました。

#### ②キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ74億96百万円減少し、306億55百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、12億5百万円の支出（前年同期は145億49百万円の収入）となりました。これは主に、法人税等の支払額148億16百万円、棚卸資産の増加額107億3百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益127億28百万円、売上債権の減少額78億11百万円、前受金の増加額33億72百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億6百万円の支出（前年同期比75.8%減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億83百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、41億65百万円の支出（前年同期比169.4%増加）となりました。これは主に、配当金の支払額141億59百万円、短期借入金の増加額100億円などによるものであります。

また、これらのほかに、現金及び現金同等物に係る換算差額18億19百万円の資金の減少がありました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年6月期連結業績予想につきましては、2024年8月7日に公表した予想から変更はありません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	38,152	30,655
受取手形、売掛金及び契約資産	22,905	14,047
仕掛品	126,087	135,257
原材料及び貯蔵品	36,314	36,289
その他	8,573	5,918
貸倒引当金	△53	△73
流動資産合計	231,978	222,095
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,862	10,722
機械装置及び運搬具(純額)	2,233	2,114
工具、器具及び備品(純額)	1,078	1,124
リース資産(純額)	71	90
土地	13,146	13,146
建設仮勘定	776	702
有形固定資産合計	28,168	27,899
無形固定資産	4,245	3,801
投資その他の資産		
投資有価証券	1,320	965
退職給付に係る資産	72	29
繰延税金資産	5,209	6,161
その他	292	309
投資その他の資産合計	6,895	7,466
固定資産合計	39,309	39,168
資産合計	271,288	261,263

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	11,514	11,500
短期借入金	—	10,000
未払法人税等	15,903	5,250
前受金	74,426	75,614
繰延収益	9,011	6,946
賞与引当金	177	1,845
役員賞与引当金	1,060	221
その他	6,191	4,453
流動負債合計	118,284	115,832
固定負債		
退職給付に係る負債	492	503
株式給付引当金	874	634
資産除去債務	248	253
その他	72	86
固定負債合計	1,688	1,479
負債合計	119,972	117,311
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	931	931
資本剰余金	1,290	1,290
利益剰余金	146,500	141,271
自己株式	△976	△976
株主資本合計	147,744	142,516
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	828	581
為替換算調整勘定	2,748	859
退職給付に係る調整累計額	△27	△27
その他の包括利益累計額合計	3,549	1,414
新株予約権	21	21
純資産合計	151,315	143,952
負債純資産合計	271,288	261,263

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)
売上高	47,305	36,737
売上原価	30,217	15,643
売上総利益	17,087	21,094
販売費及び一般管理費	6,807	5,171
営業利益	10,279	15,922
営業外収益		
受取利息	10	12
為替差益	642	—
その他	2	115
営業外収益合計	655	128
営業外費用		
支払利息	4	5
為替差損	—	3,313
その他	0	3
営業外費用合計	5	3,322
経常利益	10,929	12,728
税金等調整前四半期純利益	10,929	12,728
法人税、住民税及び事業税	2,272	4,671
法人税等調整額	955	△873
法人税等合計	3,227	3,797
四半期純利益	7,702	8,930
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,702	8,930

## (四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)
四半期純利益	7,702	8,930
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△139	△246
為替換算調整勘定	182	△1,888
退職給付に係る調整額	0	0
その他の包括利益合計	42	△2,134
四半期包括利益	7,744	6,795
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,744	6,795
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—



## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	10,929	12,728
減価償却費	1,078	965
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△25	20
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,266	1,684
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△732	△838
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△4	11
株式給付引当金の増減額(△は減少)	87	△208
受取利息及び受取配当金	△10	△12
支払利息	4	5
為替差損益(△は益)	△167	2,342
売上債権の増減額(△は増加)	9,525	7,811
棚卸資産の増減額(△は増加)	1,978	△10,703
仕入債務の増減額(△は減少)	440	168
前受金の増減額(△は減少)	3,315	3,372
その他	1,370	△3,744
小計	29,055	13,603
利息及び配当金の受取額	10	12
利息の支払額	△4	△5
法人税等の支払額	△14,512	△14,816
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,549	△1,205
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△821	△283
無形固定資産の取得による支出	△439	△22
差入保証金の差入による支出	△4	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,264	△306
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	10,000	10,000
配当金の支払額	△11,543	△14,159
その他	△2	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,546	△4,165
現金及び現金同等物に係る換算差額	659	△1,819
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	12,398	△7,496
現金及び現金同等物の期首残高	29,773	38,152
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,171	30,655

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

## (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)

(単位:百万円)

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他		
地域別				
日本	701	152	558	1,412
韓国	6,882	—	467	7,349
台湾	26,923	—	1,131	28,055
その他アジア	1,073	3	469	1,545
米国	1,302	—	2,164	3,467
欧州	4,897	—	577	5,474
合計	41,781	155	5,368	47,305
収益認識の時期				
一時点で移転される財	39,256	146	3,182	42,585
一定期間にわたり移転されるサービス	2,525	8	2,186	4,719
合計	41,781	155	5,368	47,305

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他		
地域別				
日本	2,019	176	709	2,905
韓国	10,701	49	1,176	11,928
台湾	6,634	13	1,788	8,436
その他アジア	1,328	855	906	3,090
米国	4,634	—	4,601	9,235
欧州	362	—	778	1,141
合計	25,681	1,095	9,960	36,737
収益認識の時期				
一時点で移転される財	21,874	1,069	6,008	28,952
一定期間にわたり移転されるサービス	3,806	26	3,952	7,785
合計	25,681	1,095	9,960	36,737

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## 3. 補足情報

## (1) 品目別生産実績

第1四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	46,364	54,610	17.8
	その他	952	1,656	74.0
	小計	47,316	56,267	18.9
サービス		5,368	9,960	85.6
合計		52,685	66,228	25.7

(注) 金額は販売価格で表示しております。

## (2) 品目別販売実績

第1四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	41,781	25,681	△38.5
	その他	155	1,095	606.6
	小計	41,936	26,776	△36.1
サービス		5,368	9,960	85.6
合計		47,305	36,737	△22.3